



可焊性实验报告
SOLDERABILITY TEST

公司料号 Factory P/N		客户料号 Customer P/N	客户 Customer
		Accessory part	0
试验项目 Item	◆ 喷锡板 HAL ◇ 金板 Plating Gold ◇ 沉锡Immersion Tin		

试验条件 Condition

温度 Temperature	260±5℃	时间 Time	5秒1次 5second / once
检查内容 Contents		检查结果 Results	
1. 浸润 Wettability		ACC	
2. 爆孔 Hole Void		ACC	
3. 绿油起泡 Solder Mask Blister		ACC	
4. 铜皮起泡 Copper-cold Blister		ACC	
5. 翘曲度 Warp-Twist		ACC	
6. 基材状况 Status of Laminate		ACC	
备注 Note:			
结论 Conclusion:			
◆ ACC ◆ REJ ◆ UAI			
Inspected By 检验员		Date 日期	
Approved By 审核		Date 日期	